



Title of Change:	MDB6S-MDB10SS MicroDIP Bridge Rectifiers Manufacturing Site Change.
Proposed First Ship date:	15 Dec 2019 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Benjo.Rulona@onsemi.com>
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or songyong.sim@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Assembly plant code marking from J to Q
Change Category:	Assembly Change
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Change/Addition

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites

None

External Foundry/Subcon Sites

Yangxin Everwell, China

Description and Purpose:

As part of ON Semiconductor's effort to secure available capacity and meet customer's need of a reliable source for MDB6S – MDB10SS Bridge Rectifiers in MicroDIP package, qualification of subcontractor located in Yangxin China, has been undertaken.

This new sourcing is intended to meet consistent supply and service to our customers.

These products are currently assembled and tested in a subcontractor located in Taiwan. A comparison of the differences between the current and new sites' built parts are presented below:

Process	Before Change Description	After Change Description
Wafer Fab	Pynmax, Taiwan	Tianjin Everwell, China
Assy Site	Panjit, Taiwan	Yangxin Everwell, China
Die Size	46*46 mils	50*50 mils
Green Molding Compound	ELER-8-500C	EME-E110G / EK1800G
Qty per Reel	4000	5000

	From	To
Product marking change	Assembly Plant Code J	Assembly Plant Code Q
	With AC marking	Without AC marking



Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: MDB10SS

PACKAGE : MicroDIP

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1000 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 5 min	6000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc	0/231
H3TRB	JESD22-A110	Ta:85°C, R.H:85% & bias=100V	1000 hrs	0/231
AC	JESD22-A102	Ta=121°C, 15psig (1.057kgf/cm2), RH=100%	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec	-	0/90
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	-	0/30

Electrical Characteristics Summary:

Electrical Characteristics as per datasheet specifications are not impacted. Parts covered in this change are expected to have comparable performance with the current parts in terms of quality and reliability.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
MDB10SS	MDB10SS
MDB10S	MDB10SS
MDB8S	MDB10SS
MDB6S	MDB10SS

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22903X

発行日: 23 Oct 2019

変更件名:	MDB6S-MDB10SS MicroDIP ブリッジ整流器の製造拠点の変更.		
初回出荷予定日:	15 Dec 2019 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.		
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Benjo.Rulona@onsemi.com> にお問い合わせください.		
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。		
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <songyong.sim@onsemi.com> にお問い合わせください.		
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。		
変更部品の識別:	組立工場コードマーキングが J から Q への変更		
変更カテゴリ:	組立変更		
変更サブカテゴリ:	製造サイト/追加		
影響を受ける拠点:			
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:		
無し	Yangxin Everwell, China		
説明および目的:	<p>MicroDIP パッケージの MDB6S – MDB10SS ブリッジ整流器の利用可能な生産能力の確保と、信頼性の高いソースに対するお客様のニーズを満たすためオン・セミコンダクターの取り組みの一環として、陽新県 (中国) を拠点とする外注工場が認定されました。</p> <p>この新しい契約業務は、当社のお客様に安定した供給およびサービスを提供することを目的としています。</p> <p>対象製品は現在、台湾を拠点とする外注工場では組立と検査が行われています。新旧拠点の製造製品間の相違の比較は、以下のとおりです:</p>		
	Process	Before Change Description	After Change Description
	ウェーハ製造	Pynmax, Taiwan	Tianjin Everwell, China
	組立拠点	Panjit, Taiwan	Yangxin Everwell, China
	ダイサイズ	46*46 mils	50*50 mils
	グリーンモールド・コンパウンド	ELER-8-500C	EME-E110G / EK1800G
	リール当たりの数量	4000	5000
		変更前	変更後
	製品マーキング変更	組立工場コード J	組立工場コード Q
		AC マーキング付き	AC マーキングなし



信頼性データの要約:

デバイス名: MDB10SS

パッケージ: MicroDIP

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1000 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 5 min	6000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc	0/231
H3TRB	JESD22-A110	Ta:85°C, R.H:85% & bias=100V	1000 hrs	0/231
AC	JESD22-A102	Ta=121°C, 15psig (1.057kgf/cm2), RH=100%	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec	-	0/90
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	-	0/30

電気的特性の要約:

データシートの規格に基づく電気的特性への影響はありません。今回の変更に関わる製品は、品質および信頼性の面で現行品に匹敵する性能を持つと見込まれます。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
MDB10SS	MDB10SS
MDB10S	MDB10SS
MDB8S	MDB10SS
MDB6S	MDB10SS



Appendix A: Changed Products

D

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
MDB6S		MDB10SS		
MDB8S		MDB10SS		
MDB10S		MDB10SS		